

TXS0102-Q1 2 位双向电压电平转换器 用于开漏和推挽应用

1 特性

- 无需方向控制信号
- 最大数据速率：
 - 24Mbps (推挽)
 - 2Mbps (开漏)
- 采用德州仪器 (TI) 的 NanoStar™ 集成电路封装
- A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压, B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 ($V_{CCA} \leq V_{CCB}$)
- V_{CC} 隔离特性: 如果任何一个 V_{CC} 输入接地 (GND), 则两个端口均处于高阻抗状态
- 无需电源定序: V_{CCA} 或 V_{CCB} 均可优先斜升
- I_{off} 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
 - A 端口:
 - 2500V 人体放电模型 (A114-B)
 - 250V 机器放电模型 (A115-A)
 - 1500V 充电器件模型 (C101)
 - B 端口:
 - 8kV 人体放电模型 (A114-B)
 - 250V 机器放电模型 (A115-A)
 - 1500V 充电器件模型 (C101)

2 应用

- I²C/SMBus
- UART
- 通用输入/输出 (GPIO)

3 说明

此两位同相转换器是一个双向电压电平转换器, 可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨, 其中 A 端口支持 1.65V 至 3.6V 工作电压范围, 同时可跟踪 V_{CCA} 电源, 而 B 端口支持 2.3V 至 5.5V 工作电压范围, 同时可跟踪 V_{CCB} 电源。因此, 该器件能够支持更低及更高的逻辑信号电平, 同时能够在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行双向转换。

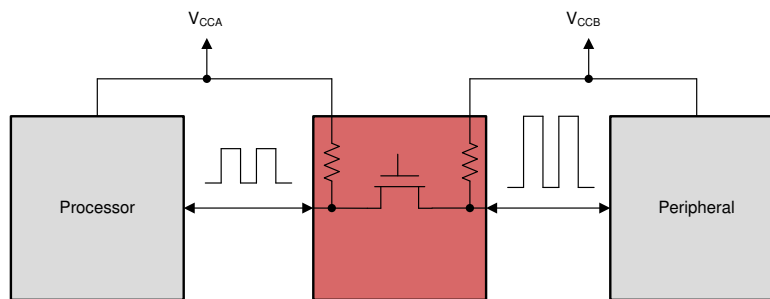
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时, 所有输入/输出均处于高阻抗状态, 从而显著减少了电源静态电流消耗。

为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态, 应将 OE 通过下拉电阻器接地; 该电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 (标称值)
TXS0102	DCT (SSOP, 8)	2.95mm × 2.80mm
	DCU (VSSOP, 8)	2.30mm × 2.00mm
	DQE (X2SON, 8)	1.40mm × 1.00mm
	DQM (X2SON, 8)	1.80mm × 1.20mm
	YZP (DSBGA, 8)	1.90mm × 0.90mm

(1) 如需了解所有可用封装, 请参阅数据表末尾的可订购产品附录。



TXS0102 典型应用方框图



内容

1 特性	1	8 详细说明	14
2 应用	1	8.1 概述.....	14
3 说明	1	8.2 功能方框图.....	14
4 Revision History	2	8.3 特性说明.....	15
5 引脚配置和功能	3	8.4 器件功能模式.....	16
6 规格	4	9 应用和实施	17
6.1 绝对最大额定值.....	4	9.1 应用信息.....	17
6.2 ESD 等级.....	4	9.2 典型应用.....	17
6.3 建议运行条件.....	5	9.3 电源相关建议.....	18
6.4 热性能信息.....	5	9.4 布局.....	18
6.5 电气特性.....	6	10 器件和文档支持	20
6.6 时序要求：V _{CCA} = 1.8V ± 0.15V.....	7	10.1 文档支持.....	20
6.7 时序要求：V _{CCA} = 2.5V ± 0.2V.....	7	10.2 接收文档更新通知.....	20
6.8 时序要求：V _{CCA} = 3.3V ± 0.3V.....	7	10.3 支持资源.....	20
6.9 开关特性：V _{CCA} = 1.8V ± 0.15V.....	8	10.4 商标.....	20
6.10 开关特性：V _{CCA} = 2.5V ± 0.2V.....	9	10.5 静电放电警告.....	20
6.11 开关特性：V _{CCA} = 3.3V ± 0.3V.....	10	10.6 术语表.....	20
6.12 典型特性.....	11	11 机械、封装和可订购信息	20
7 参数测量信息	12		

4 Revision History

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision I (August 2018) to Revision J (July 2023)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1
Changes from Revision H (April 2018) to Revision I (August 2018)	Page
• 将“建议运行条件”表中的 V _{IH} A 端口 I/O V _{CCA} 值从：1.65V 至 3.6V 更新为 1.65V 至 1.95V	5
Changes from Revision G (January 2018) to Revision H (April 2018)	Page
• 更新了 TXS0102 布局示例图.....	19

5 引脚配置和功能

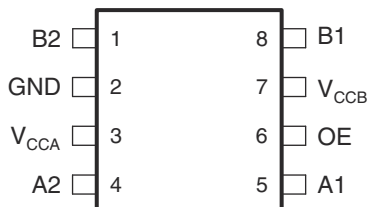


图 5-1. DCT 或 DCU 封装，
8 引脚 SSOP 和 VSSOP (顶视图)

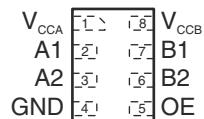


图 5-2. DQE 或 DQM 封装，
8 引脚 X2SON (顶视图)

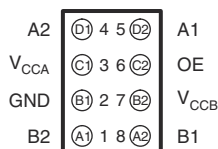


图 5-3. YZP 封装，8 引脚 DSBGA (底视图)

表 5-1. 引脚功能

引脚				类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号				
	DCT、DCU	DQE、DQM	YZP		
A1	5	2	D2	I/O	输入/输出 A。以 V _{CCA} 为基准。
A2	4	3	D1	I/O	输入/输出 A。以 V _{CCA} 为基准。
B1	8	7	A2	I/O	输入/输出 B。以 V _{CCB} 为基准。
B2	1	6	A1	I/O	输入/输出 B。以 V _{CCB} 为基准。
GND	2	4	B1	—	接地
OE	6	5	C2	I	输出使能（高电平有效）。将 OE 引脚拉为低电平，使所有输出处于三态模式。以 V _{CCA} 为基准。
V _{CCA}	3	1	C1	P	A 端口电源电压。1.65V ≤ V _{CCA} ≤ 3.6V 且 V _{CCA} ≤ V _{CCB}
V _{CCB}	7	8	B2	P	B 端口电源。2.3V ≤ V _{CCB} ≤ 5.5V

(1) I = 输入，O = 输出，I/O = 输入和输出，P = 电源

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电源电压范围, V_{CCA}		-0.5	4.6	V
电源电压范围, V_{CCB}		-0.5	6.5	V
输入电压范围, V_I ⁽²⁾	A 端口	-0.5	4.6	V
	B 端口	-0.5	6.5	
应用到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压范围, V_O ⁽²⁾	A 端口	-0.5	4.6	V
	B 端口	-0.5	6.5	
应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围, V_O ^{(2) (3)}	A 端口	-0.5	$V_{CCA} + 0.5$	V
	B 端口	-0.5	$V_{CCB} + 0.5$	
输入钳位电流, I_{IK}	$V_I < 0$		-50	mA
输出钳位电流, I_{OK}	$V_O < 0$		-50	mA
持续输出电流, I_O			±50	mA
通过 V_{CCA} 、 V_{CCB} 或 GND 的连续电流			±100	mA
结温, T_J			150	°C
贮存温度, T_{stg}		-65	150	°C

- (1) 应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级, 这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值, 则可能会超过输入和输出负电压额定值。
- (3) 建议运行条件表中提供了 V_{CCA} 和 V_{CCB} 的值。

6.2 ESD 等级

		值	单位
$V_{(ESD)}$ 静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, 所有引脚, A 端口 ⁽¹⁾	±2500	V
	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, 所有引脚, B 端口 ⁽¹⁾	±8000	V
	充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 ⁽²⁾	±1500	V
	250V 机器放电模型 (A115-A), 所有引脚	±250	V

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

6.3 建议运行条件

V_{CCI} 是与输入端口相关的电源电压。 V_{CCO} 是与输出端口相关的电源电压。

			最小值	最大值	单位
V_{CCA}	电源电压 ⁽¹⁾		1.65	3.6	V
V_{CCB}	电源电压		2.3	5.5	V
V_{IH}	高电平 输入电压	A 端口 I/O	$V_{CCA} = 1.65V$ 至 $1.95V$ $V_{CCB} = 2.3V$ 至 $5.5V$	$V_{CCI} - 0.2$	V_{CCI}
			$V_{CCA} = 1.65V$ 至 $3.6V$, $V_{CCB} = 2.3V$ 至 $5.5V$	$V_{CCI} - 0.4$	V_{CCI}
	B 端口 I/O	$V_{CCA} = 1.65V$ 至 $3.6V$, $V_{CCB} = 2.3V$ 至 $5.5V$	$V_{CCI} - 0.4$	V_{CCI}	V
	OE 输入	$V_{CCA} = 1.65V$ 至 $3.6V$, $V_{CCB} = 2.3V$ 至 $5.5V$	$V_{CCA} \times 0.65$	5.5	V
V_{IL} ⁽²⁾	低电平 输入电压	A 端口 I/O	$V_{CCA} = 1.65V$ 至 $3.6V$, $V_{CCB} = 2.3V$ 至 $5.5V$	0	0.15
		B 端口 I/O	$V_{CCA} = 1.65V$ 至 $3.6V$, $V_{CCB} = 2.3V$ 至 $5.5V$	0	0.15
	OE 输入	$V_{CCA} = 1.65V$ 至 $3.6V$, $V_{CCB} = 2.3V$ 至 $5.5V$	0	$V_{CCA} \times 0.35$	V
$\Delta t / \Delta v$	输入转换 上升或下降速率	A 端口 I/O 推挽驱动	$V_{CCA} = 1.65V$ 至 $3.6V$, $V_{CCB} = 2.3V$ 至 $5.5V$		10
		B 端口 I/O 推挽驱动	$V_{CCA} = 1.65V$ 至 $3.6V$, $V_{CCB} = 2.3V$ 至 $5.5V$		10
	控制输入	$V_{CCA} = 1.65V$ 至 $3.6V$, $V_{CCB} = 2.3V$ 至 $5.5V$			10
T_A	自然通风条件下的工作温度范围		- 40	85	°C

- (1) V_{CCA} 必须小于或等于 V_{CCB} , 并且 V_{CCA} 不得超过 3.6V
(2) 提供 V_{IL} 最大值是为了确保保持有效的 V_{OL} 。 V_{OL} 值为 V_{IL} 加上导通栅极晶体管上的压降。

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TXS0102					单位
		DCT	DCU	DQE	DQM	YZP	
		8 引脚	8 引脚	8 引脚	8 引脚	8 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	182.6	199.1	199.3	239.3	105.8	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	113.3	72.4	26.4	106.7	1.6	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	94.9	77.8	78.6	130.4	10.8	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	39.4	6.2	5.9	8.2	3.1	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	93.9	77.4	78.0	130.2	10.8	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	—	—	—	—	—	°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 [半导体和 IC 封装热指标应用报告](#)。

6.5 电气特性

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围 (除非另有说明) (1) (2) (3)

参数	测试条件	V_{CCA}	V_{CCB}	$T_A = 25^\circ\text{C}$			$T_A = -40^\circ\text{C} \text{ 至 } +85^\circ\text{C}$			单位
				最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
V_{OHA} 端口 A 输出高电压	$I_{OH} = -20\ \mu\text{A}$ $V_{IB} \geq V_{CCB} - 0.4\text{V}$	1.65V 至 3.6V	2.3V 至 5.5V				$V_{CCA} \times 0.67$			V
V_{OLA} 端口 A 输出低电压	$I_{OL} = 1\text{mA}$ $V_{IB} \leq 0.15\text{V}$	1.65V 至 3.6V	2.3V 至 5.5V						0.4	V
V_{OHB} 端口 B 输出高电压		1.65V 至 3.6V	2.3V 至 5.5V				$V_{CCB} \times 0.67$			V
V_{OLB} 端口 B 输出低电压		1.65V 至 3.6V	2.3V 至 5.5V						0.4	V
I_I 输入漏电流	OE	1.65V 至 3.6V	2.3V 至 5.5V			± 1			± 2	μA
I_{off} 局部关断电流	A 端口	0V	0V 至 5.5V			± 1			± 2	
	B 端口	0V 至 3.6V	0V			± 1			± 2	
I_{OZ} 高阻抗状态输出电流	A 或 B 端口	1.65V 至 3.6V	2.3V 至 5.5V			± 1			± 2	
I_{CCA} V_{CCA} 电源电流	$V_I = V_O = \text{开路}$ $I_O = 0$	1.65V 至 V_{CCB}	2.3V 至 5.5V						2.4	μA
		3.6V	0V						2.2	
		0V	5.5V						-1	
I_{CCB} V_{CCB} 电源电流	$V_I = V_O = \text{开路}$ $I_O = 0$	1.65V 至 V_{CCB}	2.3V 至 5.5V						12	μA
		3.6V	0V						-1	
		0V	5.5V						1	
$I_{CCA} + I_{CCB}$ 联合电源电流	$V_I = V_{CCI}$ 或 GND $I_O = 0$	1.65V 至 V_{CCB}	2.3V 至 5.5V						14.4	μA
C_I 输入电容	OE	3.3V	3.3V		2.5				3.5	pF
C_{io} 输入到输出内部电容	A 或 B 端口	3.3V	3.3V		10					pF
	A 端口				5			6		
	B 端口				6			7.5		

(1) V_{CCI} 是与输入端口相关的 V_{CC} 。

(2) V_{CCO} 是与输出端口相关的 V_{CC} 。

(3) V_{CCA} 必须小于或等于 V_{CCB} ，并且 V_{CCA} 不得超过 3.6V。

6.6 时序要求 : $V_{CCA} = 1.8V \pm 0.15V$

		$V_{CCB} = 2.5V \pm 0.2V$		$V_{CC}=3.3V \pm 0.3V$		$V_{CC}=5V \pm 0.5V$		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
数据速率	推挽驱动		21		22		24	Mbps
	开漏驱动		2		2		2	
t_w 脉冲持续时间	推挽驱动 (数据输入)	47 Ω		45		41		ns
	开漏驱动 (数据输入)	500		500		500		

6.7 时序要求 : $V_{CCA} = 2.5V \pm 0.2V$

		$V_{CCB} = 2.5V \pm 0.2V$		$V_{CC}=3.3V \pm 0.3V$		$V_{CC}=5V \pm 0.5V$		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
数据速率	推挽驱动		20		22		24	Mbps
	开漏驱动		2		2		2	
t_w 脉冲持续时间	推挽驱动 (数据输入)	50		45		41		ns
	开漏驱动 (数据输入)	500		500		500		

6.8 时序要求 : $V_{CCA} = 3.3V \pm 0.3V$

		$V_{CC}=3.3V \pm 0.3V$		$V_{CC}=5V \pm 0.5V$		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
数据速率	推挽驱动		23		24	Mbps
	开漏驱动		2		2	
t_w 脉冲持续时间	推挽驱动 (数据输入)	43		41		ns
	开漏驱动 (数据输入)	500		500		

6.9 开关特性 : $V_{CCA} = 1.8V \pm 0.15V$

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	测试条件		$V_{CCB} = 2.5V \pm 0.2V$		$V_{CCB} = 3.3V \pm 0.2V$		$V_{CCB} = 3.3V \pm 0.2V$		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
t_{PHL} 传播延迟时间 高至低电平输出	A 至 B	推挽驱动		5.3		5.4		6.8	ns
		开漏驱动	2.3	8.8	2.4	9.6	2.6	10	
t_{PLH} 传播延迟时间 低至高电平输出	A 至 B	推挽驱动		6.8		7.1		7.5	ns
		开漏驱动	45	260	36	208	27	198	
t_{PHL} 传播延迟时间 高至低电平输出	B 至 A	推挽驱动		4.4		4.5		4.7	ns
		开漏驱动	1.9	5.3	1.1	4.4	1.2	4	
t_{PLH} 传播延迟时间 低至高电平输出	B 至 A	推挽驱动		5.3		4.5		0.5	ns
		开漏驱动	45	175	36	140	27	102	
t_{en} 启用时间	OE 到 A 或 B			200		200		200	ns
t_{dis} 禁用时间	OE 到 A 或 B			50		40		35	ns
t_{rA} 输入上升时间	A 端口 上升时间	推挽驱动	3.2	9.5	2.3	9.3	2	7.6	ns
		开漏驱动	38	165	30	132	22	95	
t_{rB} 输入上升时间	B 端口 上升时间	推挽驱动	4	10.8	2.7	9.1	2.7	7.6	ns
		开漏驱动	34	145	23	106	10	58	
t_{fA} 输入下降时间	A 端口 下降时间	推挽驱动	2	5.9	1.9	6	1.7	13.3	ns
		开漏驱动	4.4	6.9	4.3	6.4	4.2	6.1	
t_{fB} 输入下降时间	B 端口 下降时间	推挽驱动	2.9	13.8	2.8	16.2	2.8	16.2	ns
		开漏驱动	6.9	13.8	7.5	16.2	7	16.2	
$t_{SK(O)}$ 偏斜 (时间), 输出	通道间偏斜			0.7		0.7		0.7	ns
最大 数据速率		推挽驱动	21		22		24		Mbps
		开漏驱动	2		2		2		

6.10 开关特性：V_{CCA} = 2.5V ± 0.2V

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

参数		测试条件		V _{CCB} = 2.5V ± 0.2V		V _{CCB} = 3.3V ± 0.3V		V _{CCB} = 5V ± 0.5V		单位
				最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
t _{PHL}	传播延迟时间 高至低电平输出	A 至 B	推挽驱动		3.2		3.7		3.8	ns
			开漏驱动	1.7	6.3	2	6	2.1	5.8	
t _{PLH}	传播延迟时间 低至高电平输出	A 至 B	推挽驱动		3.5		4.1		4.4	ns
			开漏驱动	43	250	36	206	27	190	
t _{PHL}	传播延迟时间 高至低电平输出	B 至 A	推挽驱动		3		3.6		4.3	ns
			开漏驱动	1.8	4.7	2.6	4.2	1.2	4	
t _{PLH}	传播延迟时间 低至高电平输出	B 至 A	推挽驱动		2.5		1.6		1	ns
			开漏驱动	44	170	37	140	27	103	
t _{en}	启用时间	OE 到 A 或 B			200		200		200	ns
t _{dis}	禁用时间	OE 到 A 或 B			50		40		35	ns
t _{rA}	输入上升时间	A 端口上升时间	推挽驱动	2.8	7.4	2.6	6.6	1.8	5.6	ns
			开漏驱动	3	149	28	121	24	89	
t _{rB}	输入上升时间	B 端口上升时间	推挽驱动	3.2	8.3	2.9	7.2	2.4	6.1	ns
			开漏驱动	35	151	24	112	12	64	
t _{fA}	输入下降时间	A 端口下降时间	推挽驱动	1.9	5.7	1.9	5.5	1.8	5.3	ns
			开漏驱动	4.4	6.9	4.3	6.2	4.2	5.8	
t _{fB}	输入下降时间	B 端口下降时间	推挽驱动	2.2	7.8	2.4	6.7	2.6	6.6	ns
			开漏驱动	5.1	8.8	5.4	9.4	5.4	10.4	
t _{SK(O)}	偏斜（时间），输出	通道间偏斜			0.7		0.7		0.7	ns
最大数据速率			推挽驱动	20		22		24		Mbps
			开漏驱动	2		2		2		

6.11 开关特性 : $V_{CCA} = 3.3V \pm 0.3V$

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	测试条件		$V_{CCB} = 3.3V \pm 0.2V$		$V_{CCB} = 5V \pm 0.5V$		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	
t_{PHL} 传播延迟时间 高至低电平输出	A 至 B	推挽驱动		2.4		3.1	ns
		开漏驱动	1.3	4.2	1.4	4.6	
t_{PLH} 传播延迟时间 低至高电平输出	A 至 B	推挽驱动		4.2		4.4	ns
		开漏驱动	36	204	28	165	
t_{PHL} 传播延迟时间 高至低电平输出	B 至 A	推挽驱动		2.5		3.3	ns
		开漏驱动	1	124	1	97	
t_{PLH} 传播延迟时间 低至高电平输出	B 至 A	推挽驱动		2.5		2.6	ns
		开漏驱动	3	139	3	105	
t_{en} 启用时间	OE 到 A 或 B			200		200	ns
t_{dis} 禁用时间	OE 到 A 或 B			40		35	ns
t_{rA} 输入上升时间	A 端口上升时间	推挽驱动	2.3	5.6	1.9	4.8	ns
		开漏驱动	25	116	19	85	
t_{rB} 输入上升时间	B 端口上升时间	推挽驱动	2.5	6.4	2.1	7.4	ns
		开漏驱动	26	116	14	72	
t_{fA} 输入下降时间	A 端口下降时间	推挽驱动	2	5.4	1.9	5	ns
		开漏驱动	4.3	6.1	4.2	5.7	
t_{fB} 输入下降时间	B 端口下降时间	推挽驱动	2.3	7.4	2.4	7.6	ns
		开漏驱动	5	7.6	4.8	8.3	
$t_{SK(O)}$ 偏斜 (时间), 输出	通道间偏斜			0.7		0.7	ns
最大数据速率		推挽驱动	23		24		Mbps
		开漏驱动	2		2		

6.12 典型特性

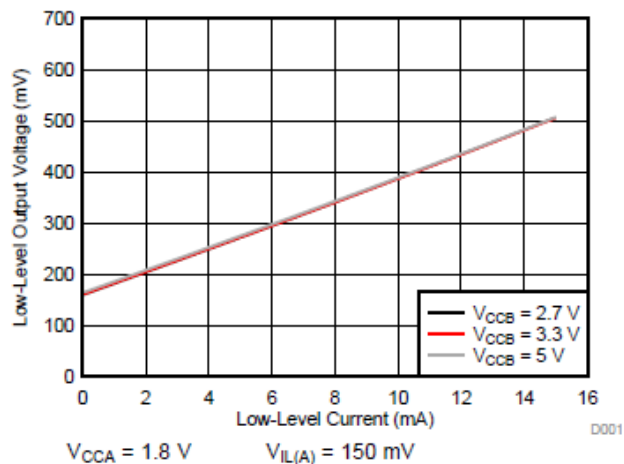


图 6-1. 低电平输出电压 ($V_{OL(Bx)}$) 与低电平电流 ($I_{OL(Bx)}$) 间的关系

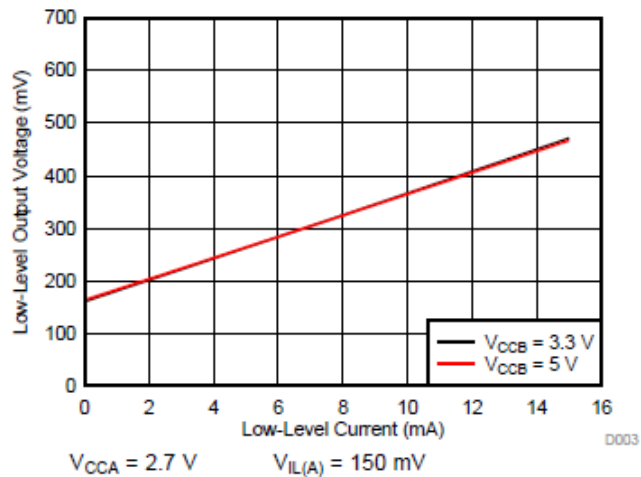


图 6-2. 低电平输出电压 ($V_{OL(Bx)}$) 与低电平电流 ($I_{OL(Bx)}$) 间的关系

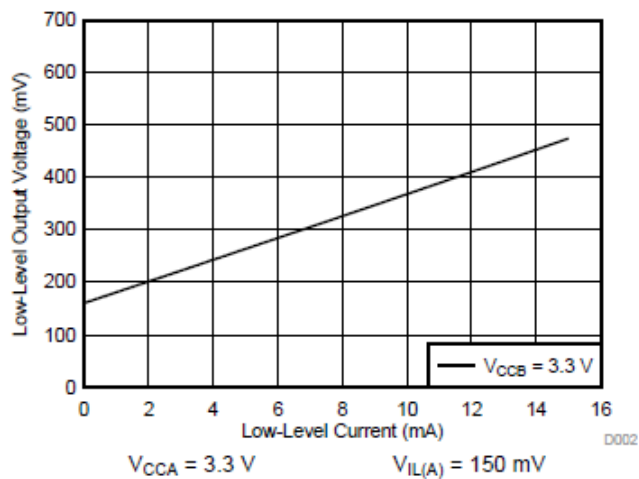


图 6-3. 低电平输出电压 ($V_{OL(Bx)}$) 与低电平电流 ($I_{OL(Bx)}$) 间的关系

7 参数测量信息

除非另有说明，否则所有输入脉冲由具有以下特性的发生器提供：

- PRR 10MHz
- $Z_O = 50\Omega$
- $dV/dt \geq 1V/ns$

备注

并非所有参数和波形都适用于所有器件。

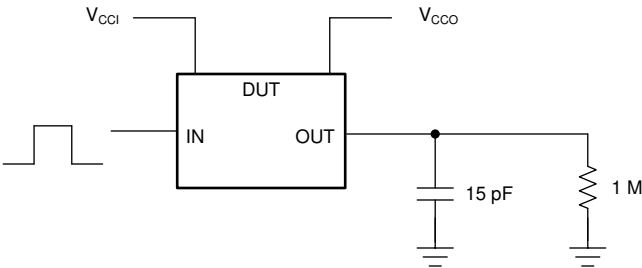


图 7-1. 使用推挽驱动器时的数据速率、脉冲持续时间、传播延迟、输出上升时间和下降时间测量

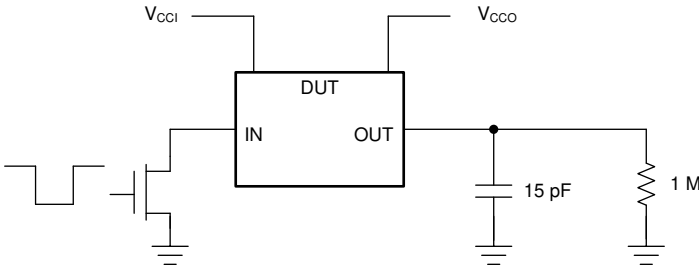


图 7-2. 使用开漏驱动器时的数据速率、脉冲持续时间、传播延迟、输出上升时间和下降时间测量

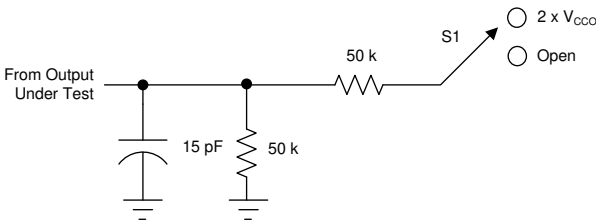


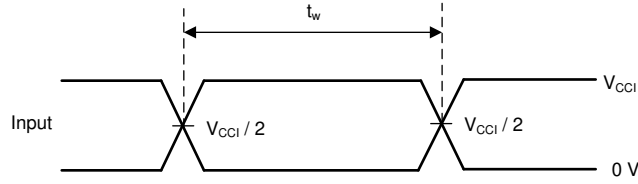
图 7-3. 启用/禁用时间测量的负载电路

表 7-1. 启用/禁用时序的开关配置

测试	S1
t_{PZL} (2)、 t_{PLZ} (1)	$2 \times V_{CCO}$
t_{PHZ} (1)、 t_{PZH} (2)	开路

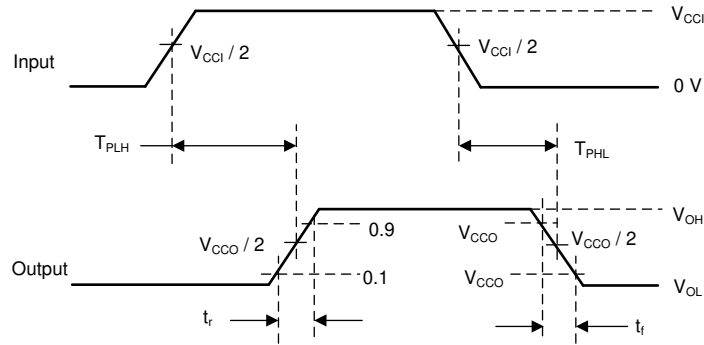
(1) t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 与 t_{dis} 一样。

(2) t_{PZL} 和 t_{PZH} 与 t_{en} 一样。



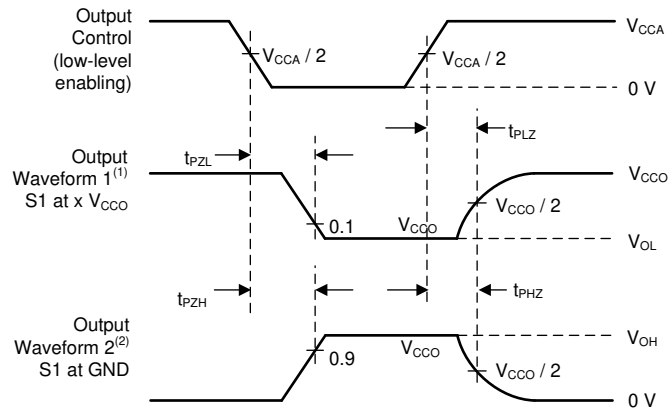
(1) 一次测量所有输入脉冲，每次测量转换一次。

图 7-4. 电压波形脉冲持续时间



(1) 一次测量所有输入脉冲，每次测量转换一次。

图 7-5. 电压波形传播延迟时间



(1) 波形 1 用于具有内部条件的输出，使得输出为低电平，除非被输出控制禁用。

(2) 波形 2 用于具有内部条件的输出，使得输出为高电平，除非被输出控制禁用。

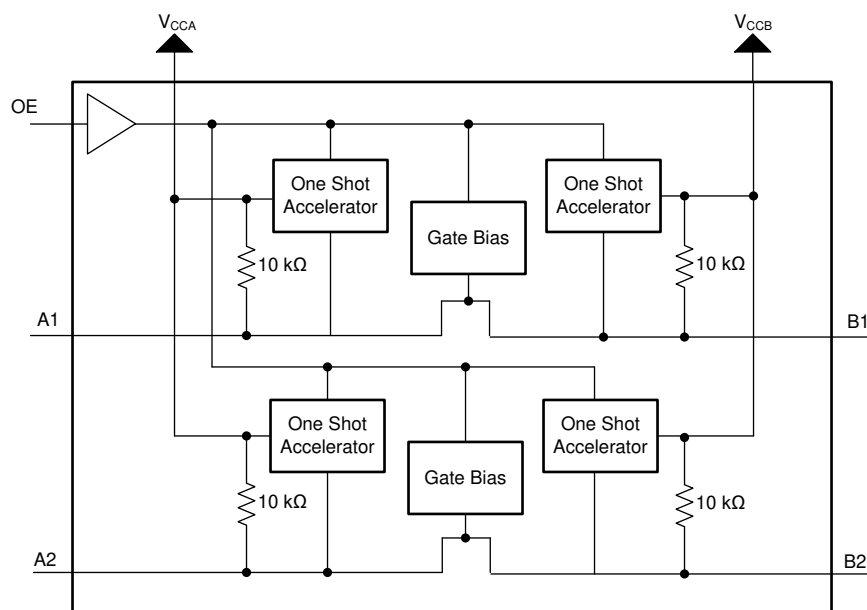
图 7-6. 电压波形启用和禁用时间

8 详细说明

8.1 概述

TXS0102 器件是专为转换逻辑电压电平而设计的无方向电压电平转换器。A 端口能够接受 1.65V 至 3.6V 的 I/O 电压，而 B 端口可接受 2.3V 至 5.5V 的 I/O 电压。该器件是一种带有边沿速率加速器（单稳态）的导通栅极架构，可提高整体数据速率。为了方便使用，此器件内已集成 10k Ω 上拉电阻器（通常被用在开漏应用中），这样就不再需要外部电阻器了。虽然这款器件设计用于开漏应用，此器件也可转换推挽 CMOS 逻辑输出。

8.2 功能方框图



8.3 特性说明

8.3.1 架构

TXS0102 架构 (请参阅图 8-1) 是基于自动方向感应的转换器, 它不需要方向控制信号来控制从 A 到 B 或从 B 到 A 的数据流方向。

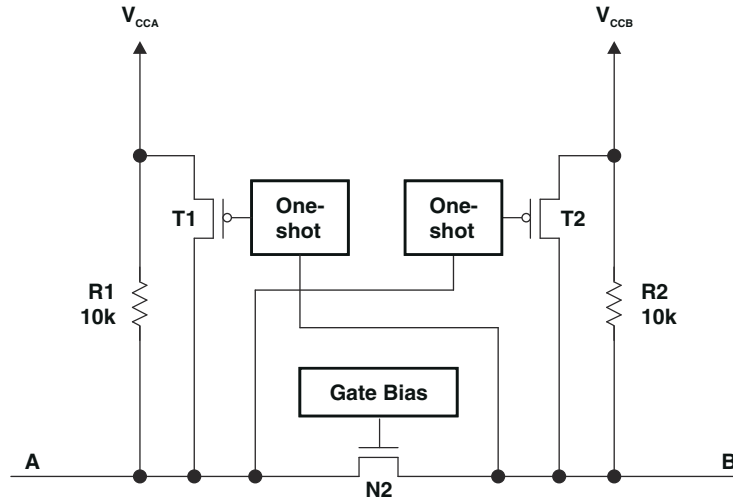


图 8-1. TXS0102 器件的架构

这两个双向通道无需方向控制信号即可独立确定数据流的方向。每个 I/O 引脚均可自动重新配置为输入或输出, 这就是自动方向控制功能的实现方式。

TXS0102 器件属于 TI “开关” 型电压转换器系列, 采用两个关键电路来实现这种电压转换:

1. 将 A 端口连接到 B 端口的 N 沟道导通栅极晶体管拓扑
- 和
2. 输出单稳态 (O.S.) 边沿速率加速器电路, 用于检测和加速 A 或 B 端口的上升沿

对于双向电压转换, 器件中包含上拉电阻器以提供直流电流源能力。N 沟道导通晶体管的 V_{GATE} 栅极偏置设置为大约比低压侧的 V_{CC} 电平高出一个阈值电压 (V_T)。数据可以沿任一方向流动, 无需控制信号的引导。

O.S 上升沿速率加速器电路通过监控输入边沿的转换来加快输出压摆率, 帮助保持器件的数据速率。在从低电平到高电平的信号上升沿期间, O.S. 电路开启 PMOS 晶体管 (T1、T2), 以在约 30ns 或输入沿 95% (以先发生者为准) 的时间内增加驱动器的电流驱动能力。这种边沿速率加速通过在低电平到高电平转换期间绕过内部 10k Ω 上拉电阻器来提供高交流驱动, 从而加快信号速度。在此加速阶段, 驱动器的输出电阻降低到大约 50 Ω 至 70 Ω 。为了尽可能降低动态 I_{CC} 和信号争用的可能性, 用户应等待 O.S. 电路关闭, 然后再向相反方向施加信号。最坏情况下的持续时间等于本数据表 [时序要求](#) 部分中提供的最小脉宽数量。

8.3.2 输入驱动器要求

持续直流电流灌入能力由连接到 TXS0102 I/O 引脚的外部系统级开漏 (或推挽) 驱动器决定。由于这些双向 I/O 电路的高带宽用于促进从输入到输出以及从输出到输入的快速变化, 因此它们的直流拉电流能力一般, 为数百微安, 具体取决于内部 10k Ω 上拉电阻。

信号的下降时间 (t_{fA} , t_{fB}) 取决于外部器件 (驱动 TXS0102 的数据 I/O) 的边沿速率和输出阻抗, 以及数据线上的容性负载。

相似地, t_{PHL} 和最大数据速率也取决于外部驱动器的输出阻抗。 t_{fA} , t_{fB} , t_{PHL} 的值和数据表中的最大数据速率假定外部驱动器的输出阻抗少于 50 Ω 。

8.3.3 输出负载注意事项

TI 建议采用较短的 PCB 布线长度进行仔细的 PCB 布局, 以避免过多容性负载并确保发生正确的 O.S. 触发。PCB 信号布线长度应保持足够短, 以使任何反射的往返延迟小于单稳态持续时间。这可确保任何反射在驱动器处都遇到低阻抗, 从而提高信号完整性。O.S. 电路设计为保持约 30ns 时间。可驱动的集总负载的最大电容也直接取决于单稳态持续时间。对于非常重的容性负载, 在信号完全驱动到正电源轨之前, 单稳态可能会超时。已设置 O.S. 持续时间, 以在动态 ICC、负载驱动能力和最大比特率这些注意事项之间实现更好的权衡。PCB 布线长度和连接器都增加了 TXS0102 器件输出的电容, 因此建议考虑此集总负载电容, 以避免 O.S. 再触发、总线争用、输出信号振荡或其他不利的系统级影响。

8.3.4 启用和禁用

TXS0102 器件具有一个通过将 OE 设定为低电平来禁用器件的 OE 输入, 这将所有 I/O 置于高阻抗状态。禁用时间 (t_{dis}) 表示 OE 引脚变为低电平与输出实际进入高阻抗状态之间的延迟。启用时间 (t_{en}) 表示 OE 引脚为高电平之后, 用户必须使单次电路变为可用的时间量。

8.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻

每个 A 端口 I/O 具有一个针对 V_{CCA} 的内部 10k Ω 上拉电阻器, 而每个 B 端口具有一个针对 V_{CCB} 的内部 10k Ω 上拉电阻器。如果需要更小值的上拉电阻器, 必须在 I/O 与 V_{CCA} 或 V_{CCB} 之间添加一个外部电阻器 (与内部 10k Ω 电阻器并联)。但是, 增加较低值的上拉电阻会影响 V_{OL} 电平。当 OE 引脚为低电平时, TXS0102 的内部上拉电阻被禁用。

8.4 器件功能模式

此器件有两种功能模式: 启用和禁用。为了禁用此器件, 将 OE 输入设定为低电平, 这样将所有 I/O 置于高阻抗状态。将 OE 输入设定为高电平将启用此器件。

9 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

9.1 应用信息

TXS0102 器件可用于弥合两个电压节点之间的数字开关兼容性差距，从而成功连接电子系统中的逻辑阈值电平。它应该用于点对点拓扑结构中，用于将在不同接口电压下运行的器件或系统相互连接起来。其主要目标应用用于连接数据 I/O 上的开漏驱动器，例如 I²C 或 1 线，其中数据是双向的，没有可用的控制信号。该器件也可用于推挽驱动器被接至数据 I/O 的应用，但是对于此类推挽应用，TXB0102 也许是一个更好的选择。

9.2 典型应用

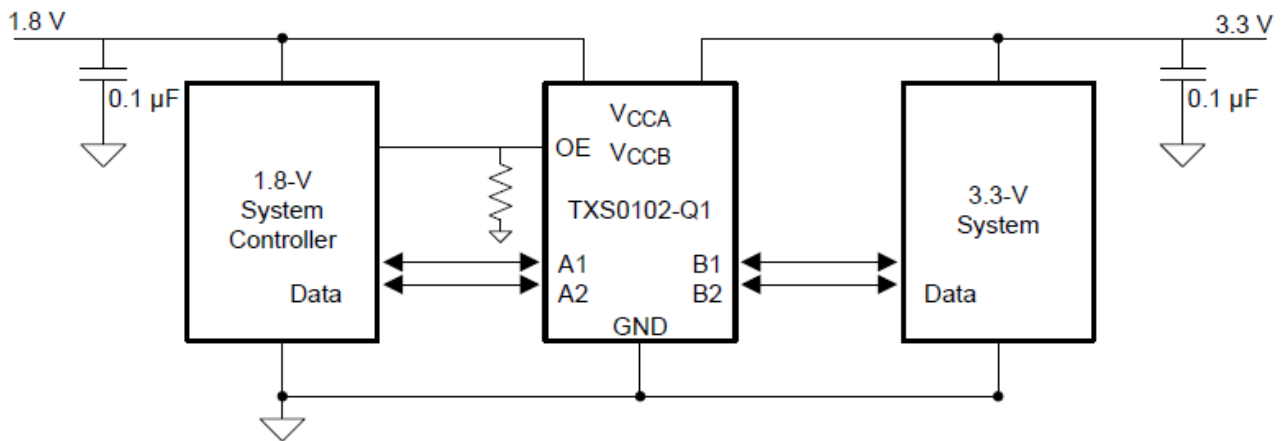


图 9-1. 典型应用电路

9.2.1 设计要求

对于这个设计示例，请使用表 9-1 中列出的参数。并确保 $V_{CCA} \leq V_{CCB}$ 。

表 9-1. 设计参数

设计参数	示例值
输入电压范围	1.65 至 3.6V
输出电压范围	2.3 至 5.5V

9.2.2 详细设计过程

要开始设计过程，请确定以下内容：

- 输入电压范围
 - 使用驱动 TXS0102 器件的器件电源电压来确定输入电压范围。要获得有效的逻辑高电平，此值必须超过输入端口的 V_{IH} 。要获得有效的逻辑低电平，这个值必须小于输入端口的 V_{IL} 。
- 输出电压范围
 - 使用 TXS0102 器件正在驱动的器件电源电压来确定输出电压范围。
 - TXS0102 器件具有 $10k\Omega$ 内部上拉电阻器。如果需要的话，可增加外部上拉电阻器来减少信号迹线上的总 RC。
 - 一个外部下拉电阻器减少输出 V_{OH} 和 V_{OL} 。使用公式 1 来计算由外部下拉电阻器产生的 V_{OH} 。

$$V_{OH} = V_{CCx} \times R_{PD} / (R_{PD} + 10k\Omega)$$

其中：

- V_{CCx} 是 V_{CCA} 或 V_{CCB} 上的电源电压
- R_{PD} 是外部下拉电阻的值

9.2.3 应用曲线

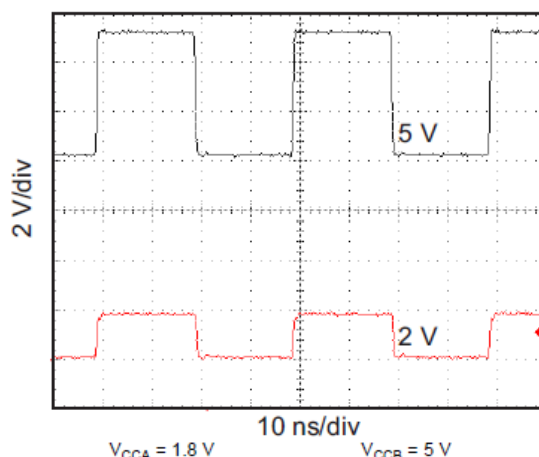


图 9-2. 2.5MHz 信号的电平转换

9.3 电源相关建议

运行期间，确保 V_{CCA} 始终小于等于 V_{CCB} 。在上电运行期间，每个电源的时序不会损坏器件，因此任一电源都可以首先斜升。输出使能 (OE) 输入电路被设计成由 V_{CCA} 供电，并且当 (OE) 输入为低电平时，所有输出被置于高阻抗状态。为了确保输出在加电或断电期间为高阻抗状态，OE 输入引脚必须通过一个下拉电阻器接至 GND，并且在 V_{CCA} 和 V_{CCB} 完全斜升且稳定前一定不能被启用。对地下拉电阻器的最小值由驱动器的电流供源能力确定。

9.4 布局

9.4.1 布局指南

为确保器件的可靠性，建议按照以下常见印刷电路板布局布线指南进行操作：

- 应在电源上使用旁路电容器，并应尽可能靠近 V_{CCA} 、 V_{CCB} 引脚和 G_{ND} 引脚放置。

- 为了避免过多负载，应该使用短布线。
- PCB 信号布线长度必须保持足够短，以使任何反射的往返延迟小于单稳态持续时间（约 30ns），从而确保任何反射在源驱动器处都遇到低阻抗。

9.4.2 布局示例

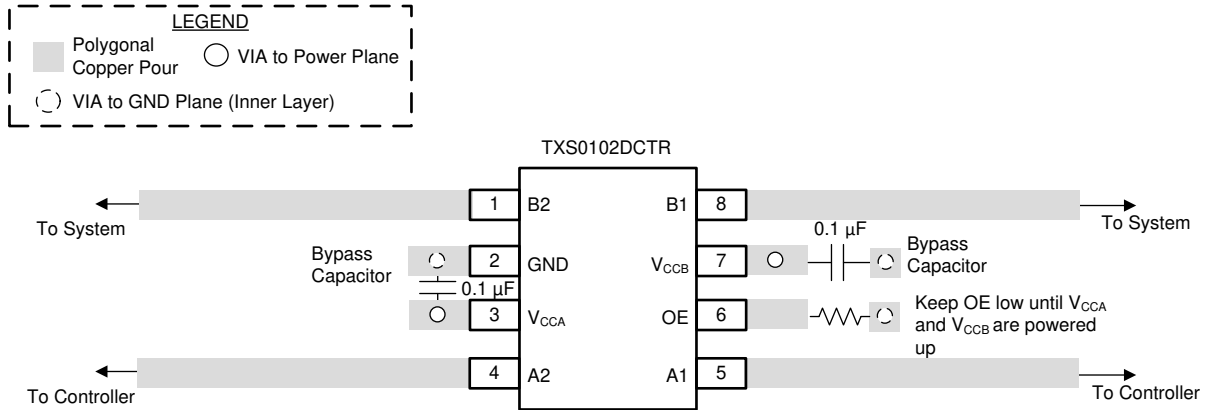


图 9-3. TXS0102 布局示例

10 器件和文档支持

10.1 文档支持

10.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI), [使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南 应用手册](#)
- 德州仪器 (TI), [TXS 和 LSF 自动双向转换器件的 VOL 影响因素 应用手册](#)
- 德州仪器 (TI), [TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求 应用手册](#)
- 德州仪器 (TI), [上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响 应用手册](#)
- 德州仪器 (TI), [逻辑简介 应用手册](#)
- 德州仪器 (TI), [TI 逻辑和线性产品指南 选择和解决方案指南](#)
- 德州仪器 (TI), [洗衣机解决方案指南 选择和解决方案指南](#)
- 德州仪器 (TI), [TI 智能手机解决方案指南 选择和解决方案指南](#)

10.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [订阅更新](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

10.3 支持资源

[TI E2E™ 支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题可获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的《[使用条款](#)》。

10.4 商标

NanoStar™ is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

10.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

11 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TXS0102DCTR	ACTIVE	SM8	DCT	8	3000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(35UT, NFE) (R, Z)	Samples
TXS0102DCTRE4	ACTIVE	SM8	DCT	8	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(35UT, NFE) (R, Z)	Samples
TXS0102DCTT	ACTIVE	SM8	DCT	8	250	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(35UT, NFE) (R, Z)	Samples
TXS0102DCTTE4	ACTIVE	SM8	DCT	8	250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(35UT, NFE) (R, Z)	Samples
TXS0102DCTTG4	ACTIVE	SM8	DCT	8	250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(35UT, NFE) (R, Z)	Samples
TXS0102DCUR	ACTIVE	VSSOP	DCU	8	3000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(FE, NFEQ, NFER) NZ	Samples
TXS0102DCURG4	ACTIVE	VSSOP	DCU	8	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	NFER	Samples
TXS0102DCUT	ACTIVE	VSSOP	DCU	8	250	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(FE, NFEQ, NFER) NZ	Samples
TXS0102DCUTG4	ACTIVE	VSSOP	DCU	8	250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	NFER	Samples
TXS0102DQER	ACTIVE	X2SON	DQE	8	5000	RoHS & Green	NIPDAUAG	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2H	Samples
TXS0102DQMR	ACTIVE	X2SON	DQM	8	3000	RoHS & Green	NIPDAU NIPDAUAG	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2H (2H7, 2HR) (2HG, 2HH)	Samples
TXS0102YZPR	ACTIVE	DSBGA	YZP	8	3000	RoHS & Green	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(2H, 2HN)	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of ≤ 1000 ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the ≤ 1000 ppm threshold requirement.

⁽³⁾ MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

⁽⁴⁾ There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

⁽⁵⁾ Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

⁽⁶⁾ Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TXS0102 :

- Automotive : [TXS0102-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

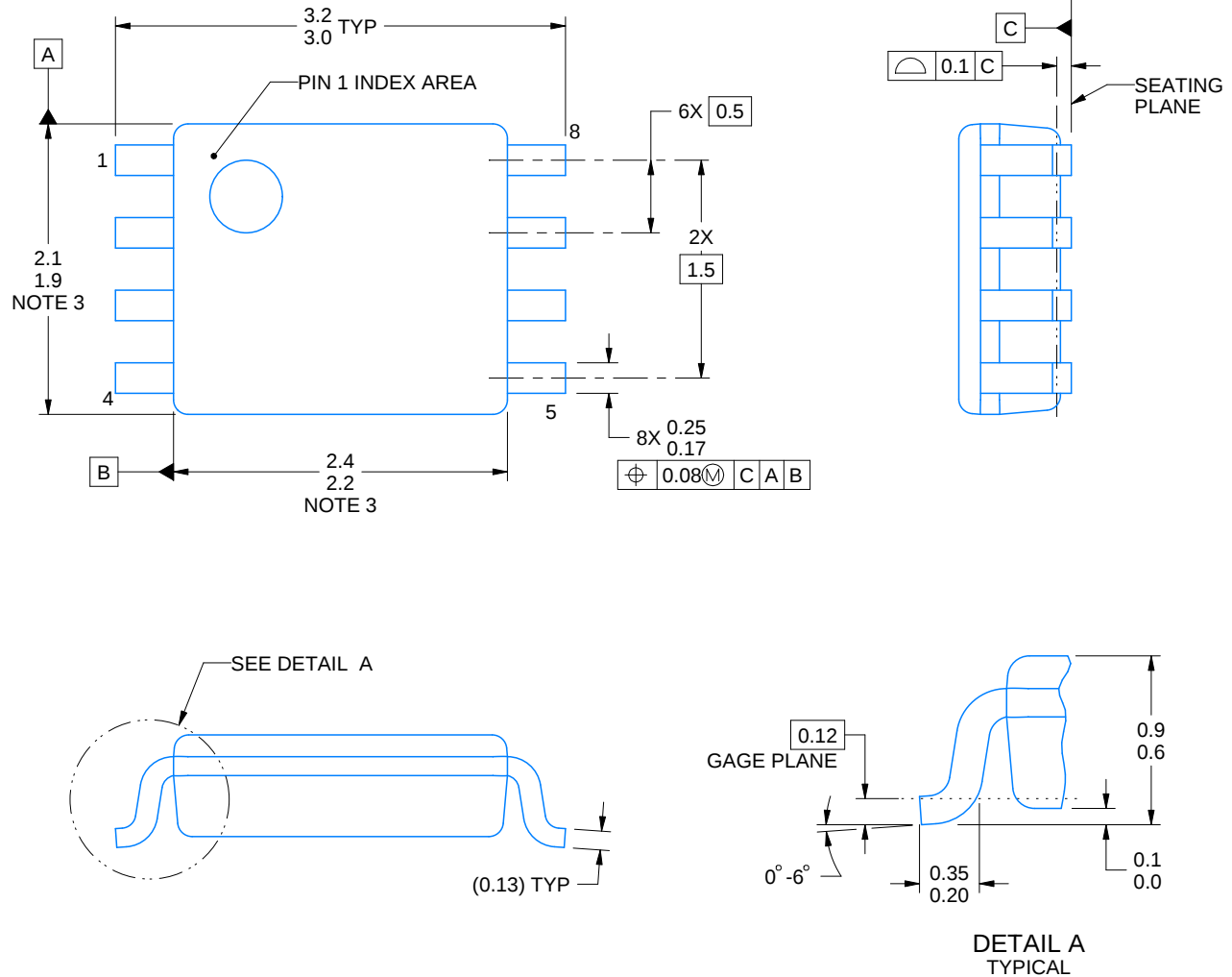
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TXS0102DCTR	SM8	DCI	8	3000	180.0	12.4	3.15	4.35	1.55	4.0	12.0	Q3
TXS0102DCTT	SM8	DCI	8	250	180.0	12.4	3.15	4.35	1.55	4.0	12.0	Q3
TXS0102DCUR	VSSOP	DCU	8	3000	180.0	9.0	2.25	3.4	1.0	4.0	8.0	Q3
TXS0102DCUR	VSSOP	DCU	8	3000	180.0	8.4	2.25	3.35	1.05	4.0	8.0	Q3
TXS0102DCURG4	VSSOP	DCU	8	3000	180.0	8.4	2.25	3.35	1.05	4.0	8.0	Q3
TXS0102DCUTG4	VSSOP	DCU	8	250	180.0	8.4	2.25	3.35	1.05	4.0	8.0	Q3
TXS0102DQER	X2SON	DQE	8	5000	180.0	8.4	1.2	1.6	0.55	4.0	8.0	Q1
TXS0102DQMR	X2SON	DQM	8	3000	180.0	8.4	1.57	2.21	0.59	4.0	8.0	Q1
TXS0102DQMR	X2SON	DQM	8	3000	180.0	9.5	1.4	2.0	0.5	4.0	8.0	Q1
TXS0102YZPR	DSBGA	YZP	8	3000	180.0	8.4	1.02	2.02	0.63	4.0	8.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TXS0102DCTR	SM8	DCT	8	3000	190.0	190.0	30.0
TXS0102DCTT	SM8	DCT	8	250	190.0	190.0	30.0
TXS0102DCUR	VSSOP	DCU	8	3000	182.0	182.0	20.0
TXS0102DCUR	VSSOP	DCU	8	3000	202.0	201.0	28.0
TXS0102DCURG4	VSSOP	DCU	8	3000	202.0	201.0	28.0
TXS0102DCUTG4	VSSOP	DCU	8	250	202.0	201.0	28.0
TXS0102DQER	X2SON	DQE	8	5000	202.0	201.0	28.0
TXS0102DQMR	X2SON	DQM	8	3000	202.0	201.0	28.0
TXS0102DQMR	X2SON	DQM	8	3000	184.0	184.0	19.0
TXS0102YZPR	DSBGA	YZP	8	3000	182.0	182.0	20.0



4225266/A 09/2014

NOTES:

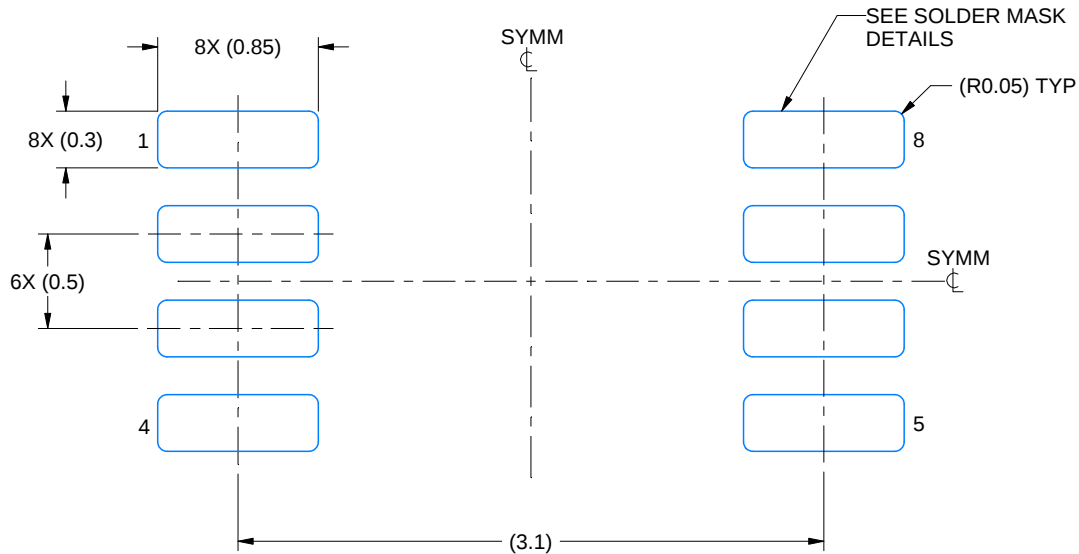
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-187 variation CA.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

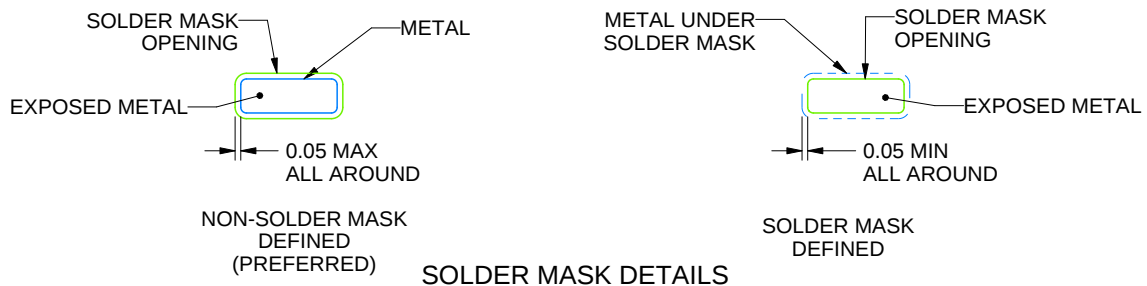
DCU0008A

VSSOP - 0.9 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 25X



4225266/A 09/2014

NOTES: (continued)

5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

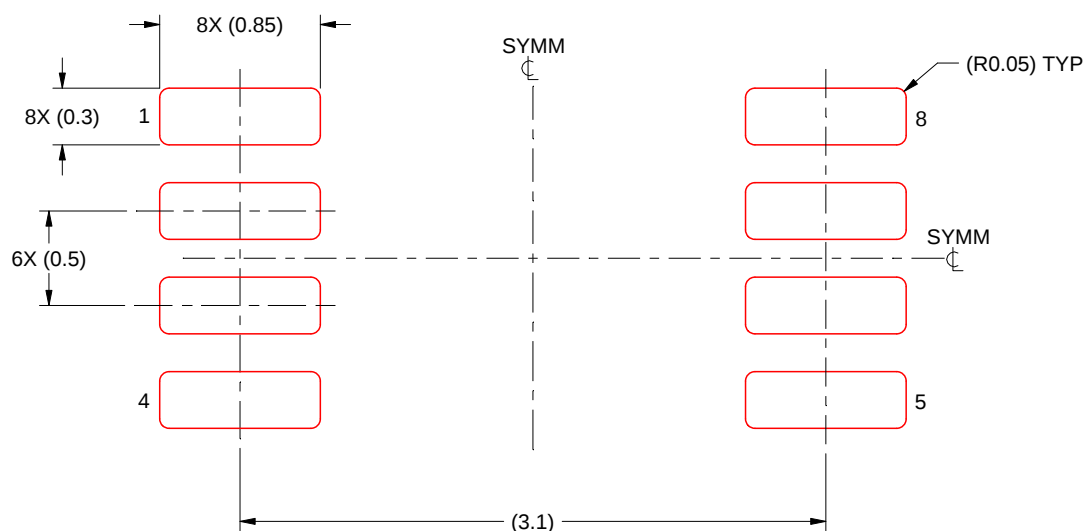
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DCU0008A

VSSOP - 0.9 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 25X

4225266/A 09/2014

NOTES: (continued)

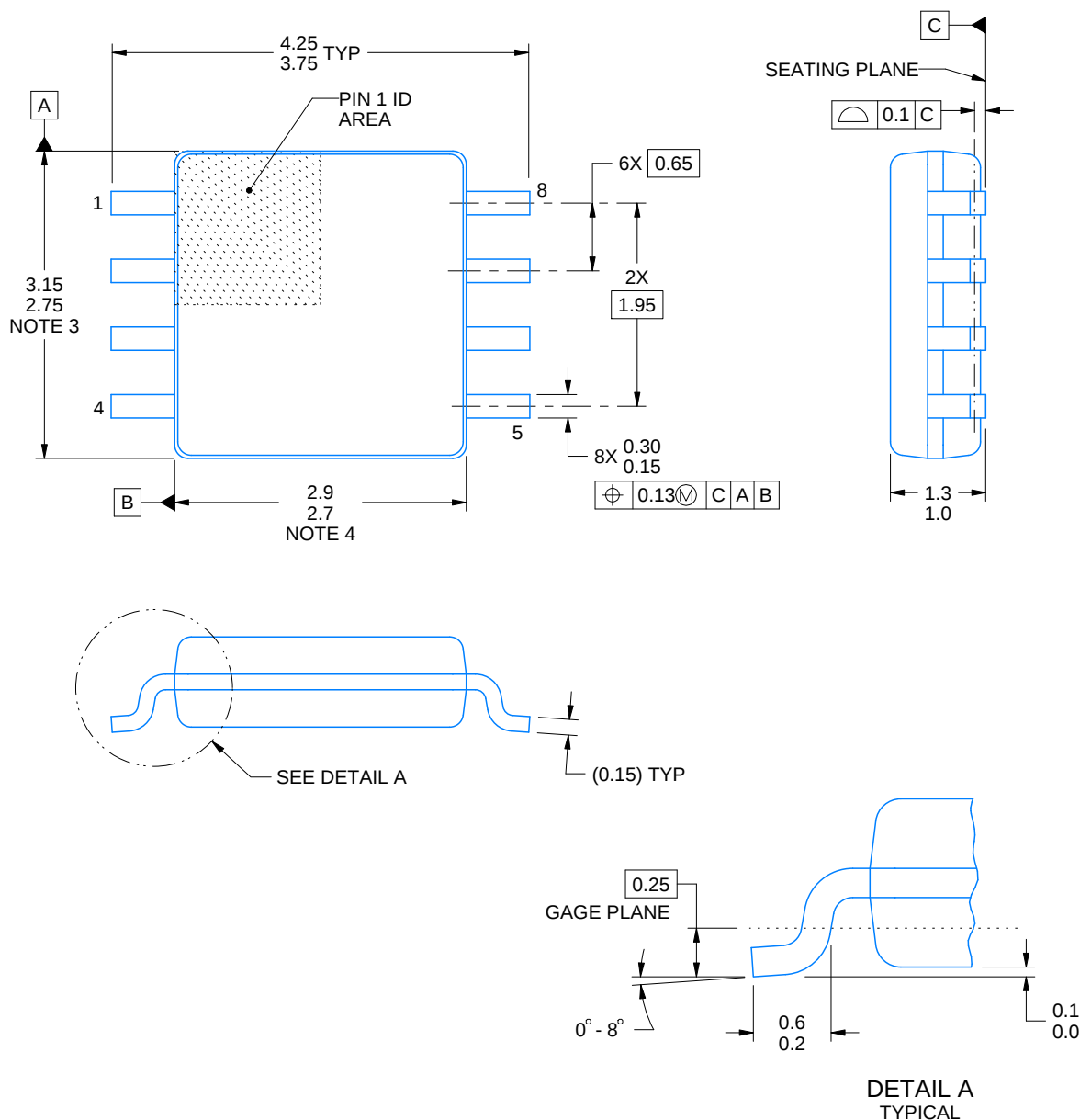
7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



PACKAGE OUTLINE

SSOP - 1.3 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4220784/C 06/2021

NOTES:

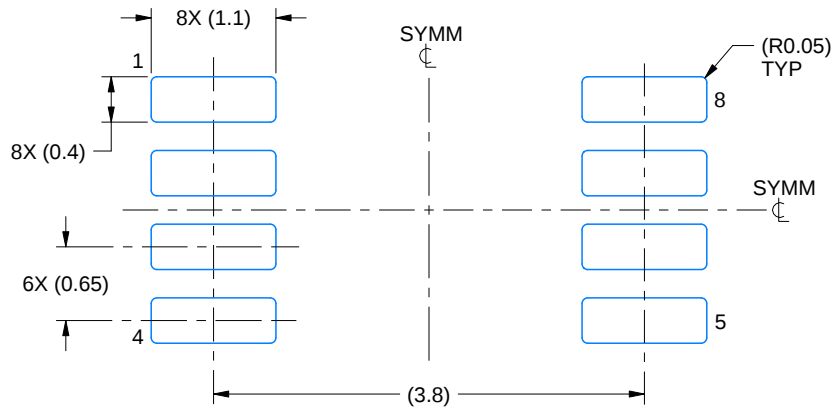
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

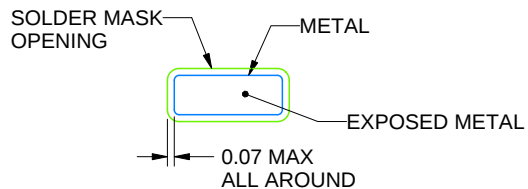
DCT0008A

SSOP - 1.3 mm max height

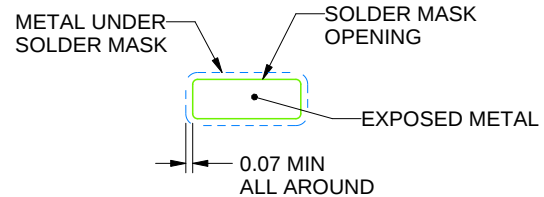
SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



NON SOLDER MASK
DEFINED



SOLDER MASK
DEFINED

SOLDER MASK DETAILS

4220784/C 06/2021

NOTES: (continued)

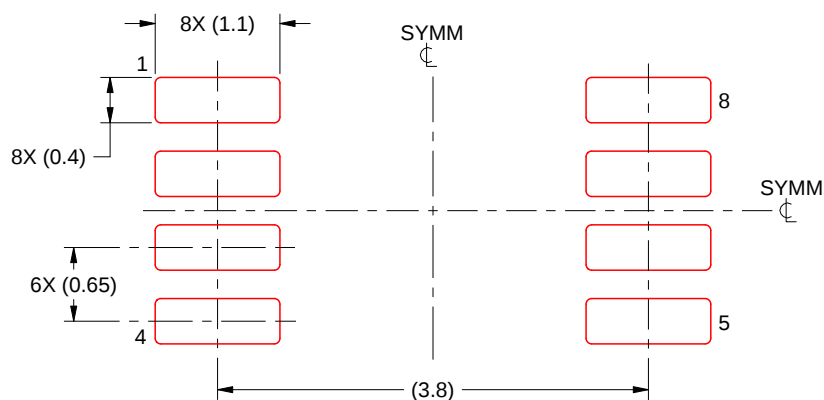
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DCT0008A

SSOP - 1.3 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

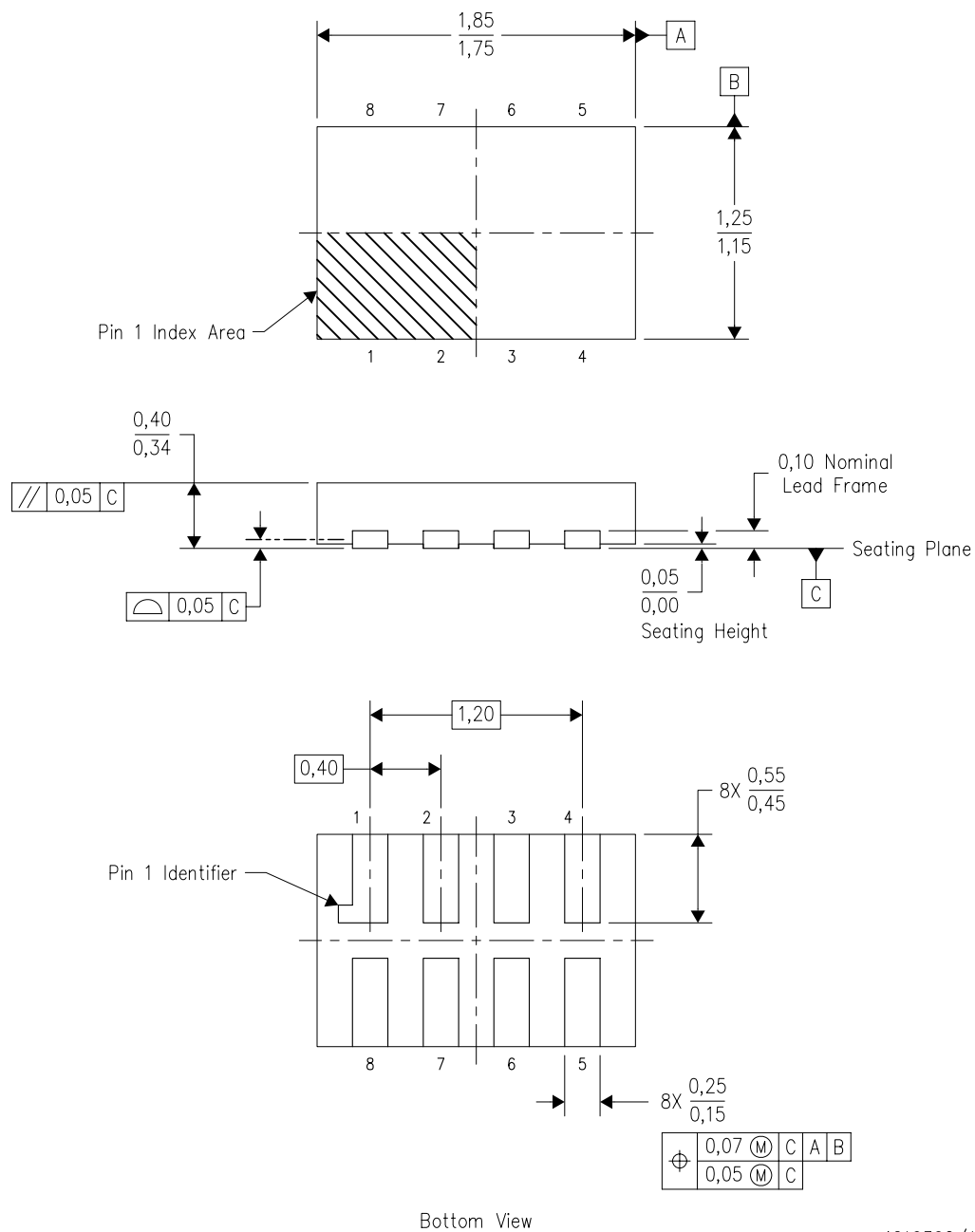
4220784/C 06/2021

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

DQM (R-PX2SON-N8)

PLASTIC SMALL OUTLINE NO-LEAD



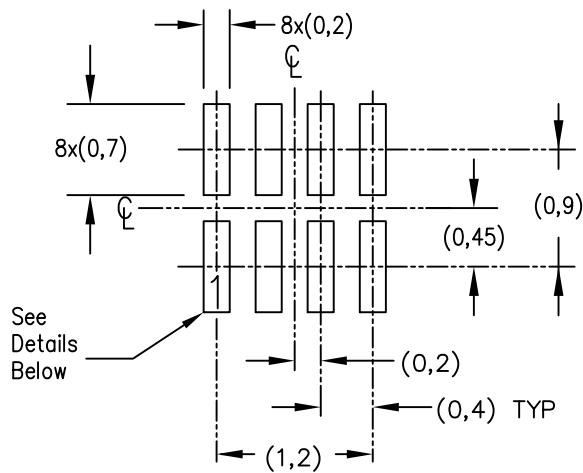
4210302/A 06/2009

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. SON (Small Outline No-Lead) package configuration.

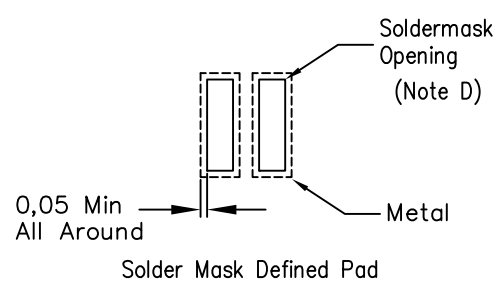
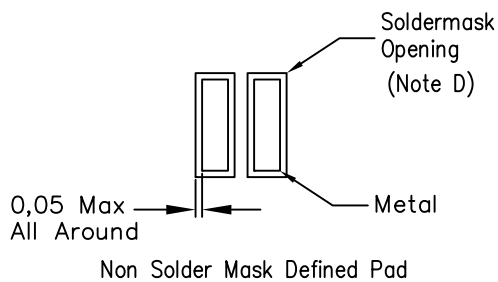
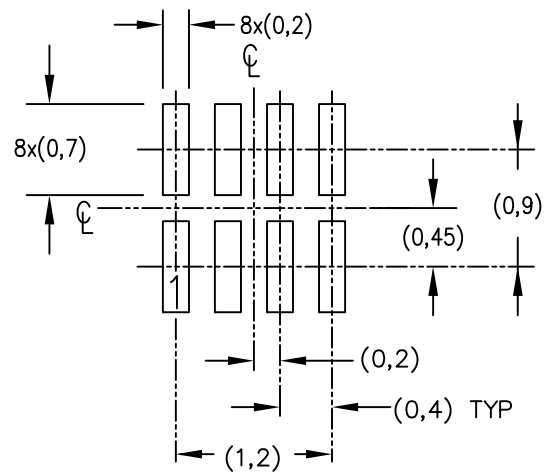
DQM (R-PX2SON-N8)

PLASTIC SMALL OUTLINE NO-LEAD

Example Board Layout



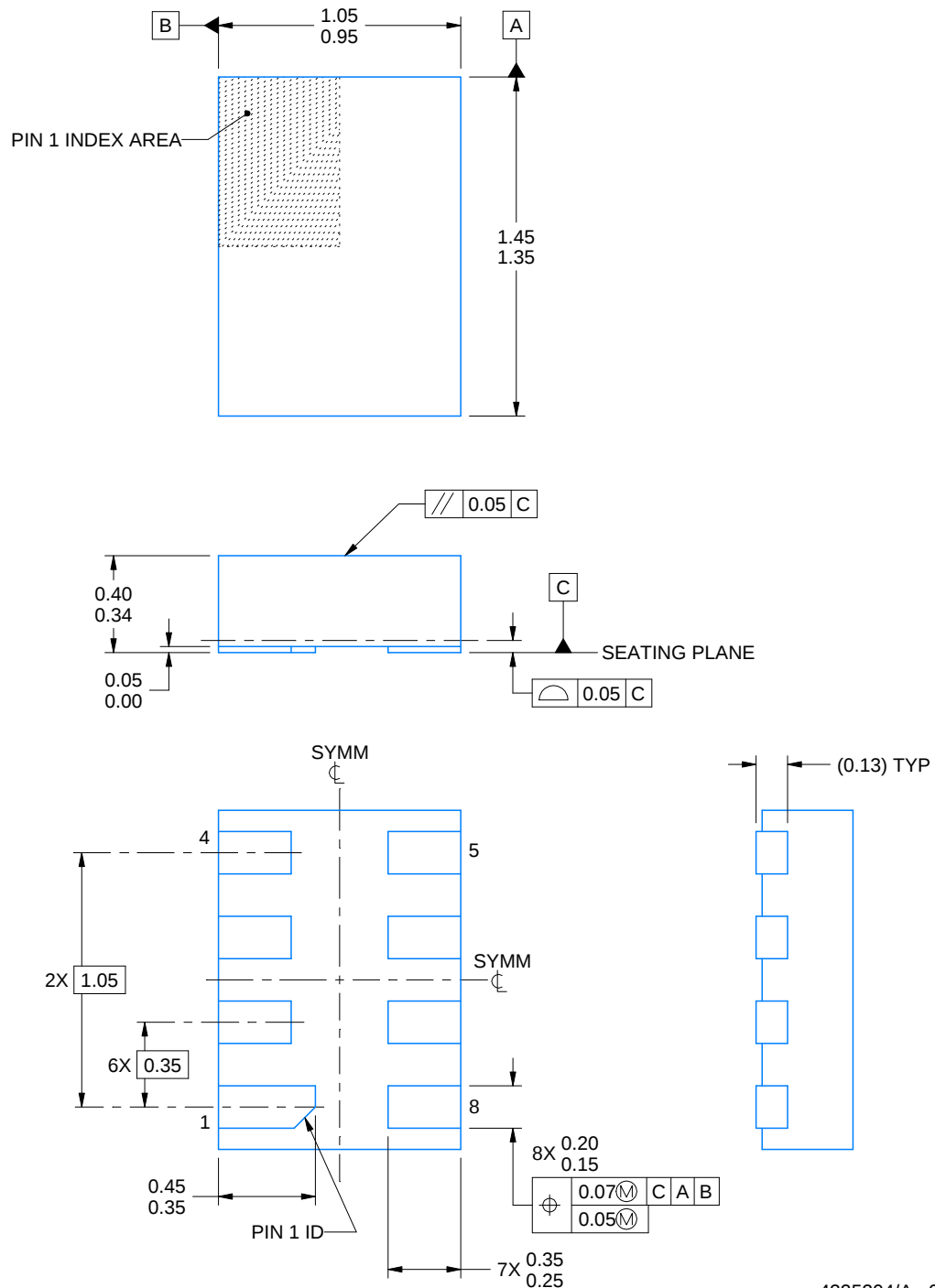
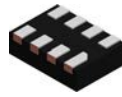
Example Stencil Design
0.1mm Thick Stencil
(Note C)



Solder Mask Details

4218746/A 07/13

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC 7525 for stencil design considerations.
 - D. Customers should contact their board fabrication site for recommended solder mask tolerances.



4225204/A 08/2019

NOTES:

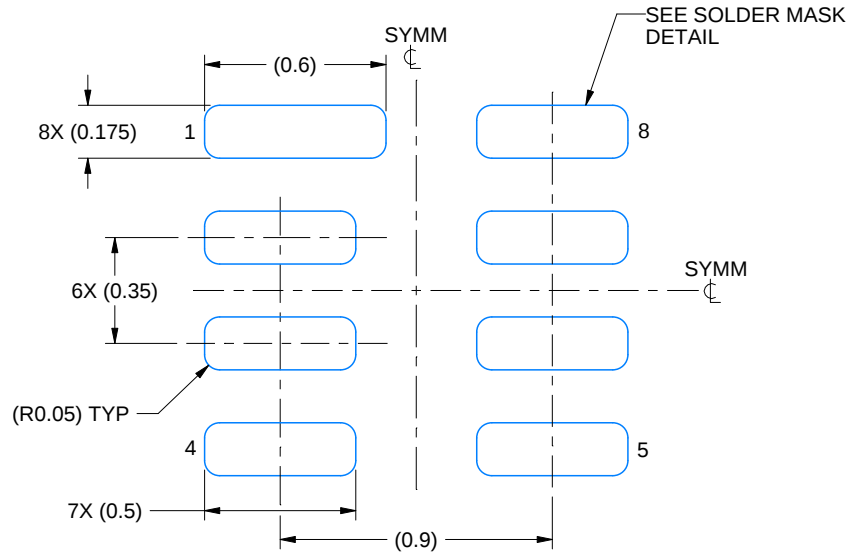
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package complies to JEDEC MO-287 variation X2EAF.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

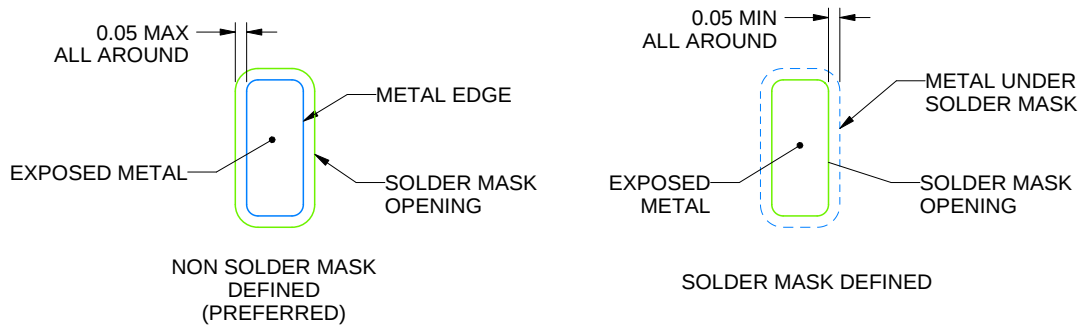
DQE0008A

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 40X



SOLDER MASK DETAILS

4225204/A 08/2019

NOTES: (continued)

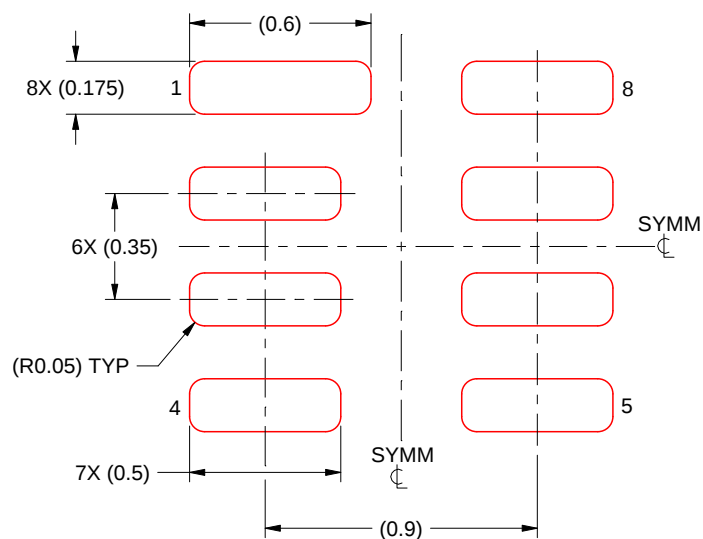
- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DQE0008A

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



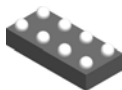
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.075 MM THICK STENCIL
SCALE: 40X

4225204/A 08/2019

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

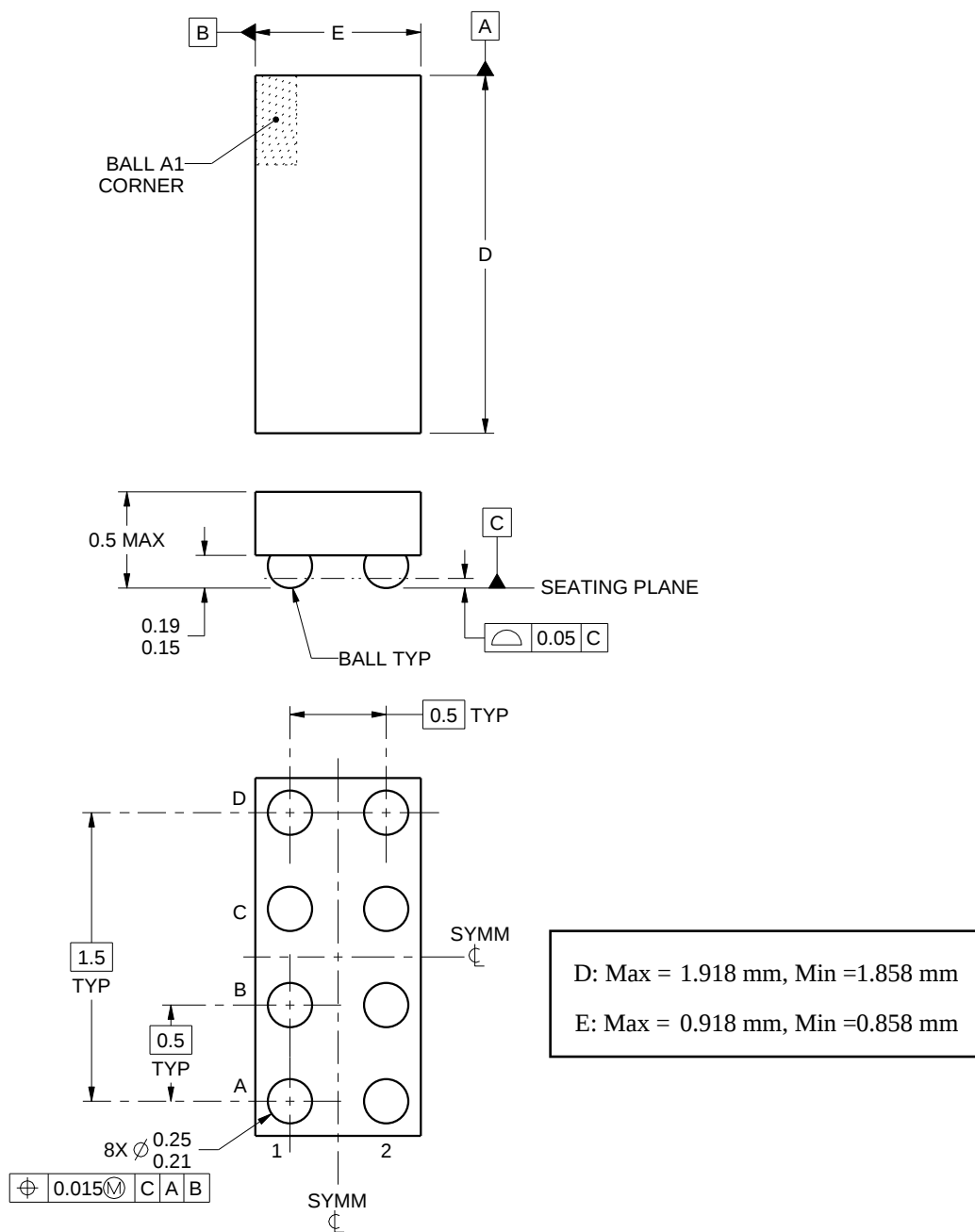
YZP0008



PACKAGE OUTLINE

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



4223082/A 07/2016

NOTES:

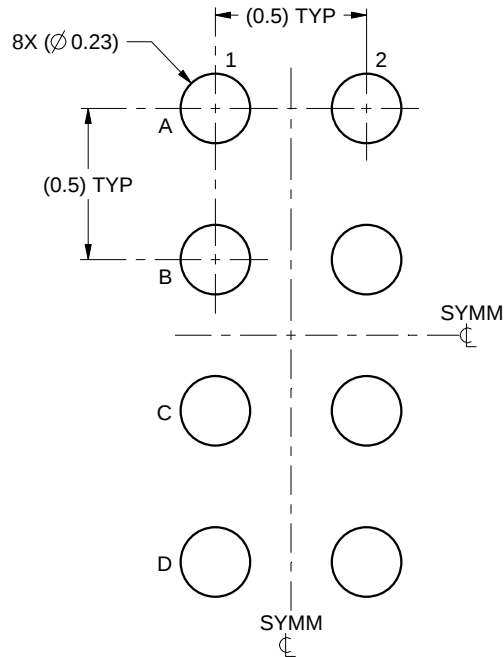
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

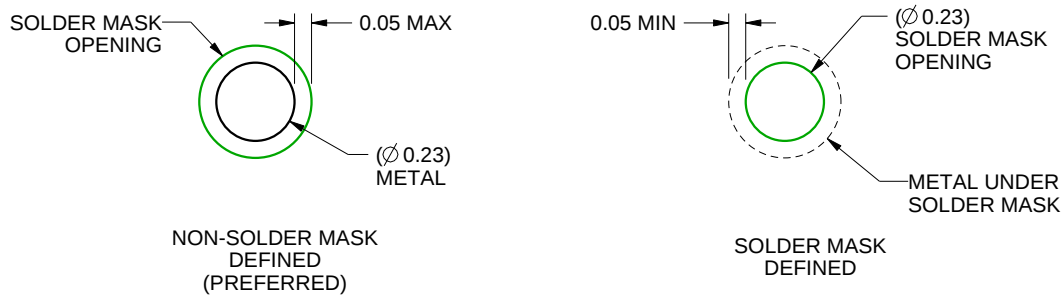
YZP0008

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:40X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4223082/A 07/2016

NOTES: (continued)

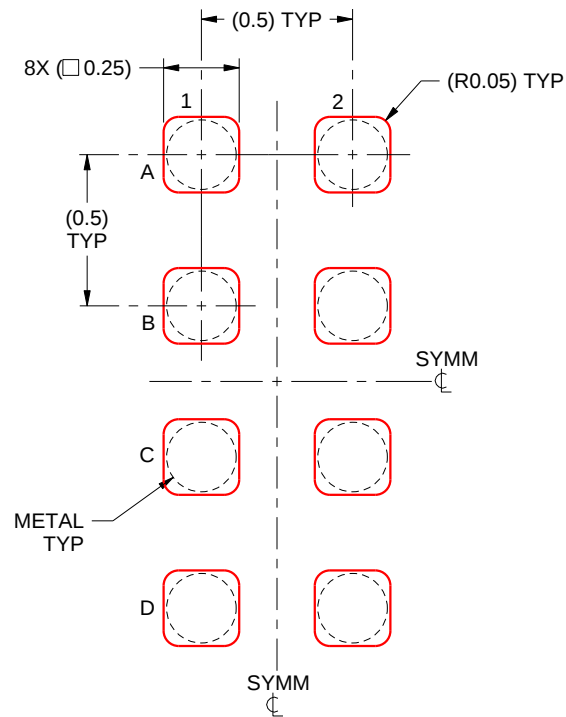
3. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

YZP0008

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE:40X

4223082/A 07/2016

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司